

# 企業ニュース 東京精密

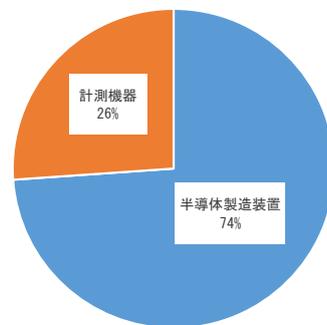
(東証1部：7729) <http://www.accretech.jp>

作成者：兵藤三郎

## 計測事業も展開する半導体製造装置メーカー

◇21. 3期売上高構成比

1949年、東京精密工具として設立し、各種測定機の製造販売を行ってきた。1962年に現社名に変更した。半導体製造装置事業にも注力、2002年に浜松ホトニクス社と業務提携し、レーザダイシング装置を共同開発。2012年には三菱マテリアルより「精密ブレード（刃）事業」を譲受し、消耗品ビジネスにも参入した。現在、右図のように2セグメントで事業展開。半導体製造装置（以下半導体）は主に後工程（組立・最終試験工程）用の製造装置を製造、ウェーハプロービングマシン（チップの電気特性試験機）、ダイシングマシン（チップに切断する装置）、ポリッシュグラインダ（ウェーハを薄くする装置）などが主要製品。計測機器（以下計測）は工業製品の検査工程、特に自動車産業界で採用されている。真円度・円筒形状測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機、三次元座標測定機などの汎用計測機器の他、インラインの計測システムなどを展開している。



(出所) 東京精密資料よりCAM作成

## 半導体は好調継続、生産能力増強施策が奏功

22. 3期・第2四半期累計（4-9月）の連結業績は、売上高が615億円、前年同期比36%増、営業利益が129億円、同106%増。半導体の売上増加に加え、昨年度は軟調に推移した計測も回復に転じ、2桁増収、営業利益は倍増した。受注高も885億円、同2. 2倍に拡大した。半導体は加工装置（ダイサ、研削）の伸長が貢献した。計測でも21. 3期・第2四半期（7-9月）をボトムに受注高が回復基調を維持している。自動車用途に加え、機械・機械部品需要が増加し、会社の想定を上振れた。

22. 3期の会社計画は、売上高が1, 280億円、前期比32%増、営業利益が265億円、同70%増。従来計画からは売上高で100億円、営業利益で45億円上方修正した。半導体では高水準の需要が続くものの、従来通り短期的な調整があると想定。ただし特段減速の兆候がある訳ではなく、一方で部材の値上がりや、生産スペース確保のため外部の倉庫を借りた賃借料、減価償却費の増加などのコスト増は勘案した計画で、多分に保守的な前提と考えられよう。受注増加に伴い生産能力の増強が課題となっており、足元では計測の製造拠点である土浦工場でプローバーの生産を開始、23. 3期には飯能工場の稼働を開始する。加えて、名古屋工場の活用も検討していく方針。

### [株価動向・投資判断]

半導体が伸長、計測も緩やかながら回復基調となり、業績が拡大している。受注も好調、生産能力増強施策が奏功し、来期も増収増益が見込める銘柄。

<7729 東京精 業績：日本基準>

[今期予想の配当金は発行会社予想]

	売上高	営業利益	経常利益	当期利益	1株利益	1株配当
	百万円 (伸び率)	百万円 (伸び率)	百万円 (伸び率)	百万円 (伸び率)	円	円
20. 3	87, 927 (▲ 13)	12, 282 (▲ 39)	12, 360 (▲ 41)	7, 156 (▲ 51)	171. 9	76. 00
21. 3	97, 105 ( 10)	15, 562 ( 27)	15, 867 ( 28)	12, 175 ( 70)	293. 8	104. 00
22. 3 予	128, 000 ( 32)	26, 500 ( 70)	26, 500 ( 67)	19, 300 ( 59)	470. 7	168. 00



[主要株価指標] (売買単位：100株)

株価 (2021/11/19)	5, 140 円
年初来高値 (高値日)	5, 740 円 (21/6/7)
同 安値 (安値日)	4, 025 円 (21/10/5)
予想 P E R (22. 3 予)	10. 9 倍
1株株主資本 (PBR算出用)	2, 966. 1 円
P B R	1. 73 倍
予想配当利回り	3. 27 %
(1株当たり配当金年168. 00円)	
R O E (21. 3)	10. 9 %
発行済み株式数	4, 184 万株